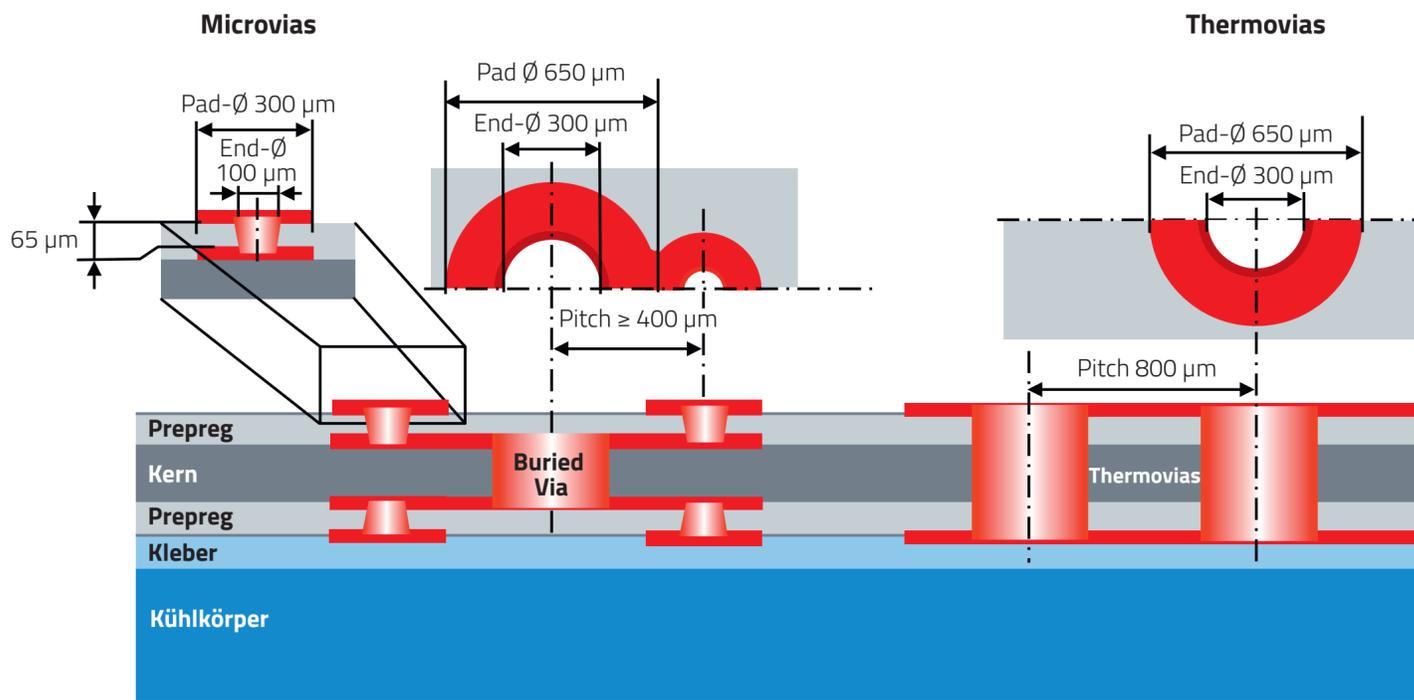
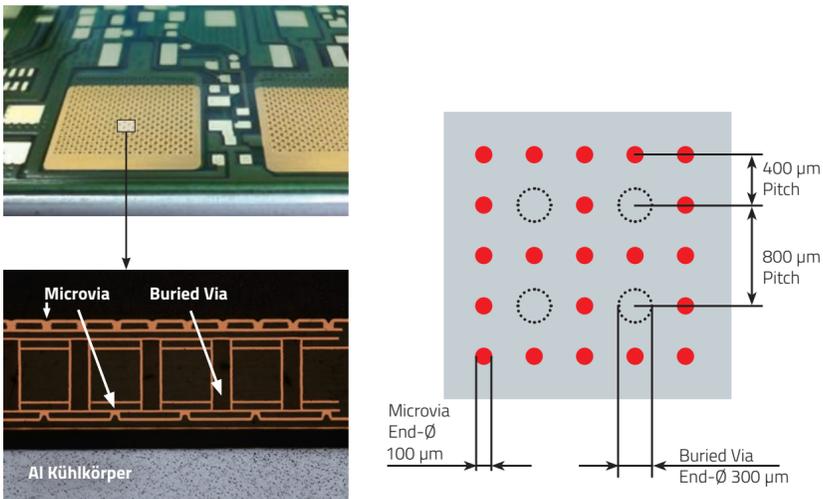


# WÄRMEMANAGEMENT

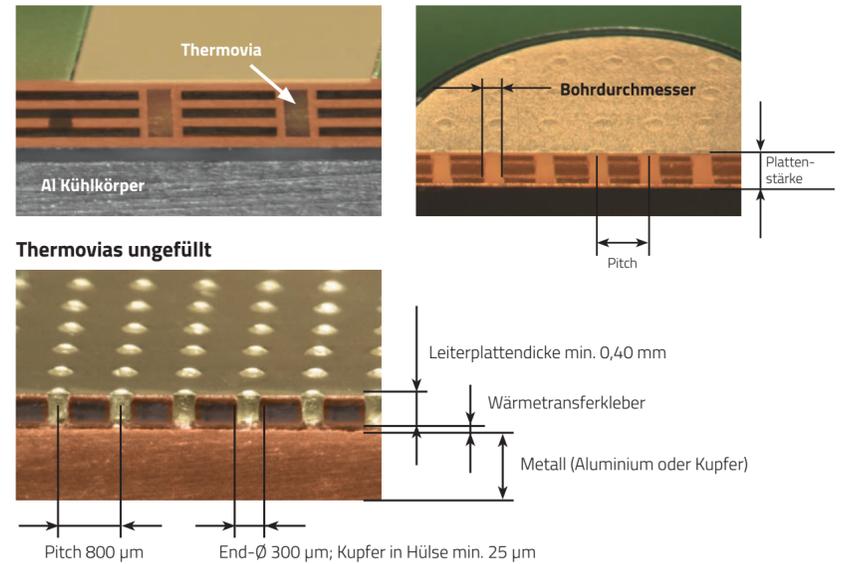
## Standard Designregeln



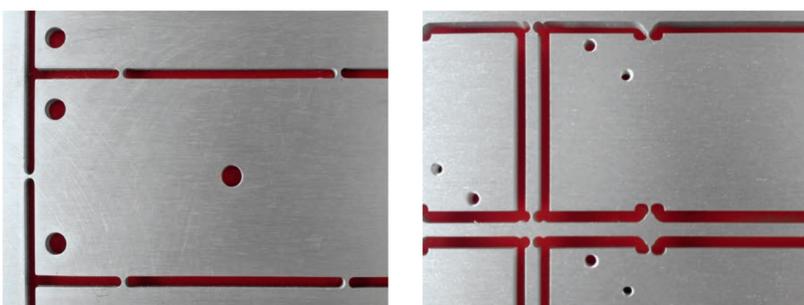
## Kombination Microvia, Buried Via als Thermovias



## Thermovias gefüllt (Filled & Capped Via, IPC-4761, Type VII)



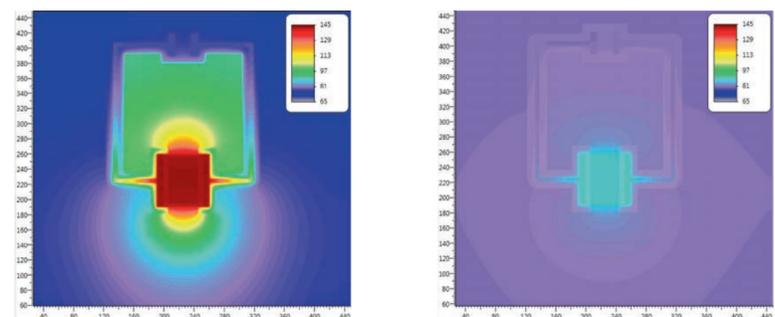
## Sollbruchstellen Heatsink



**Positive Sollbruchstellen**  
Bruchstelle befindet sich im Fräskanal außerhalb der Leiterplattenkontur.

**Negative Sollbruchstellen**  
Bruchstelle innerhalb der Leiterplattenkontur. Zusätzliche Zwischenstege zur Stabilität des Nutzens benötigt.

## Thermische Simulation



Leiterplatte 2 Lagen, 1,6 mm, verbessertes Layout, ohne Thermovias

Leiterplatte 2 Lagen, mit Heatsink, 1,6 mm, verbessertes Layout, mit Thermovias

Eine thermische Simulation der Leiterplatte kann helfen, den besten Leiterplattenaufbau und das optimale Layout auszuwählen.